

令和5年4月24日  
総務省四国総合通信局

## 令和5年度「ICT 海外展開パッケージ支援事業の地方枠」 の公募開始について

総務省では、2023年4月24日（月）から2023年5月25日（木）まで、デジタル技術の海外展開に関する取組を行う地域に根ざしたICT中小企業を対象に、「ICT 海外展開パッケージ支援事業の地方枠」の公募を行います。

今般、本公募情報が以下の事務局ホームページにて公開されましたので、お知らせします。

デジタル技術の海外展開に関心がある事業者の皆さまにおかれては、ご確認いただき申請を積極的にご検討ください。

問合せ・申請は、事務局を務めます（株）富士通総研までお願い致します。

### <公募情報>

事務局ホームページ：<https://ictopssjle.jp/>

### <問合せ先>

事務局：（株）富士通総研

メールアドレス：info@ictopssjle.jp